

卡爾蔡司 (ZEISS) 竹科敲磚 顯微鏡檢測能量助力半導體研發再進化

Carl Zeiss (ZEISS) Held a Brick-breaking Ceremony for Its New Branch at the Hsinchu Science Park-Helping Elevate Semiconductor Research and Development Competence at the Park via Advanced Microscopy Detection Technologies

カール・ツァイス着工式顕微鏡技術で半導体開発を進化させる

文・圖／投資組 李淑美



敲磚紀念活動合影，右2起：卡爾蔡司顯微鏡事業部CSO-Martin Fischer、臺灣蔡司章平達總經理、科管局胡世民副局長、卡爾蔡司顯微鏡事業部CEO-Dr.Michael Albiez、科管局投資組李淑美組長、臺灣蔡司蔡慧總監

卡爾蔡司股份有限公司竹科分公司於 2024 年 1 月 23 日舉辦進駐科學園區的敲磚紀念活動，由德國卡爾蔡司顯微鏡事業部 CEO-Dr. Michael Albiez 及臺灣蔡司的章平達總經理共同主持，科管局胡世民副局長及相關同仁應邀出席，活動現場充滿蓄勢待發的氣勢！

卡爾蔡司集團專注研發半導體製造設備、顯微鏡、醫療技術、眼鏡鏡片、相機鏡頭等技術，公司考量臺灣半導體發展量能與在臺客戶的重要性日漸提升，於 2023 年 10 月進駐竹科設立研發中心，並與集團總公司合作引進最新的檢測設備和技術。此外，未來也將針對分公司在臺自主研發投入更多資源，提供客製化解決方案，以更貼近在臺客戶需求。

卡爾蔡司在入區後，可提供電子顯微鏡、光學顯微鏡、3D X-ray 顯微鏡等三大領域顯微鏡設備及相應的最新檢測技術，未來將持續投

入半導體故障分析領域發展，聚焦先進製程研發和第三代半導體材料所需檢測分析，藉由公司在顯微鏡最新技術，提供我國半導體先進製程研發的關鍵助力。

敲磚活動後，卡爾蔡司公司前往科管局拜訪，經由交流介紹，對於科學園區的發展、特有的產官學研整合優勢及半導體產業生態系現況，均有了更進一步的認識，公司會後對於進駐科學園區，表達出了高度信心。



來賓合影，卡爾蔡司顯微鏡事業部CEO-Dr. Michael Albiez (左5)、科管局投資組李淑美組長(中)、臺灣蔡司章平達總經理(右4)